

INVESTOR RELATIONS

2023년 주주총회



유의사항 [Disclaimer]

본 자료는 한국채택국제회계기준 연결실적에 대한 경영실적 및 재무성과를 바탕으로 작성되었습니다.

또한 본 자료는 미래에 대한 "예측정보"를 포함하고 있으며, 이러한 "예측정보"는 향후 경영환경의 변화 등에 따라 불확실성으로 인하여, 실제 경영현황 및 재무실적에 긍정적 또는 부정적으로 영향을 미칠 수 있습니다.

- 국내외 국가정책변경에 따른 세율 변동 (FTA, 관세, 법인세 등)
- 환율 및 이자 변동을 포함한 국내외 금융시장의 동향
- 주요 매출시장의 환경의 예상치 못한 급격한 변화
- 회사내의 전략적인 의사결정

이러한 불확실성으로 인해 회사의 실제 미래실적은 "예측정보"에 기재되거나 암시된 내용과는 중대한 차이가 있을 수 있습니다.

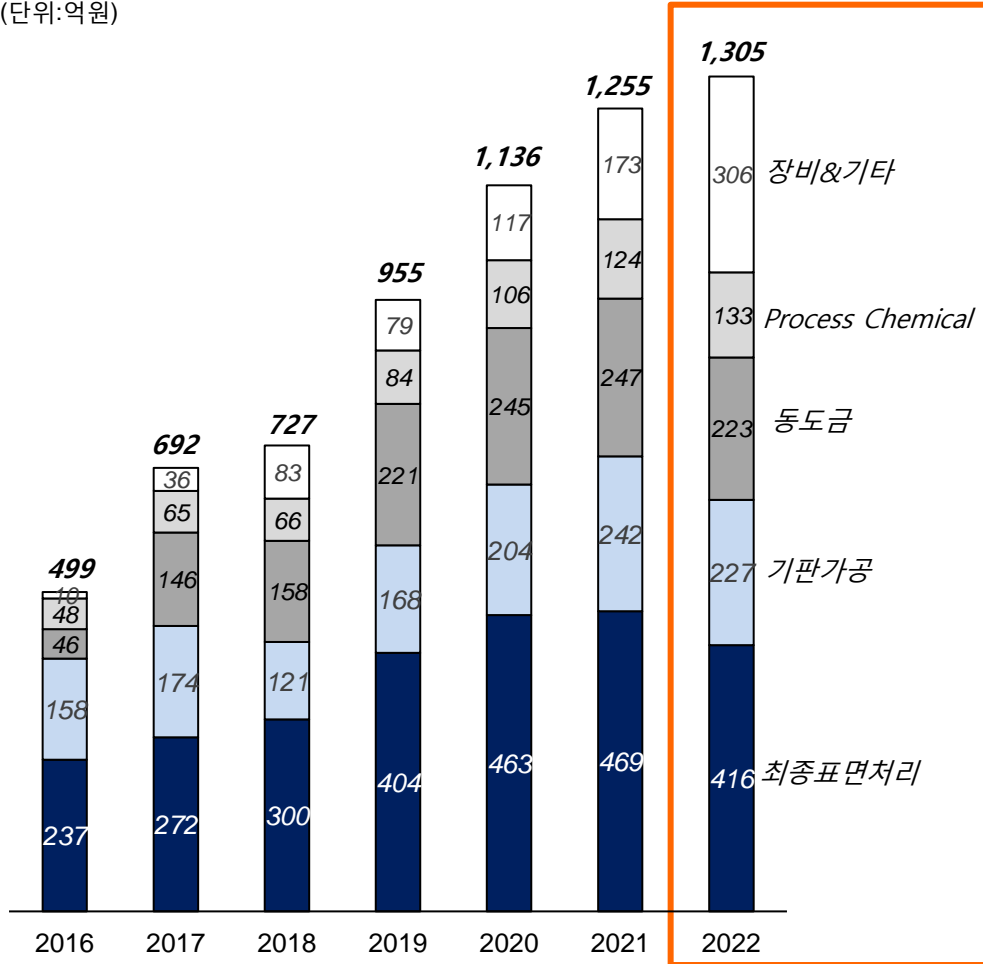


2022 REVIEW

Sales Result

■ 최종표면처리 □ 기판가공 ■ 동도금 □ Process Chemical □ 기타 및 장비

(단위: 억원)



• 시장 상황 악화로 인한 제품매출의 감소

- ✓ 전체 매출은 21년 대비 +50억원으로, 역대 최대 매출을 기록
- ✓ 당사의 이익률에 기여하는 제품매출은 전년대비 83억원 감소,
- ✓ 마진율이 낮은 상품매출 및 신규분야 매출 증가로 최대매출 대비 낮은 이익률을 기록
 - 상품(원재료) 매출 확대 : 21년 94억 → 22년 180억원
 - B2C 분야 신규 매출 : 22년 42억원 기록

• 코로나 바이러스로 인한 공급차질, 스마트폰 수요감소

- ✓ 코로나 이슈로 22년 중국시장 내 스마트폰 向 PCB 공장이 가동중단 사태 다수 발생
- ✓ 중국법인의 매출 역신장 (21년 314억원 → 22년 258억원)

• 어려운 시장상황에서의 성장 Point

- ✓ 스마트폰 외 PKG 기판 및 전장기판의 침투 가속화
- ✓ PKG 고객사 장비도입이 늦어짐에 따라 당사 또한 예상매출보다 하회하였으나...
- ✓ ...전장과 Process Chemical 제품군의 약진으로 어려운 시장상황에서 매출을 확대하였으며, 최종 고객사 승인을 통하여 동박 양산 start

Key issue for 2022 – Cost Side

영업이익과 당기순이익 모두 21년 172.3억원 / 140.4억원에서
22년 영업이익 33.4억원 (전년대비 -138.9억원) , 당기순이익 26억원 (전년대비 -114.4억원)으로 하락하였음

소재(극동박)의 양산전환비용

- 22년 비용지출 약 95억원
 - ✓ 22년 하반기부터 본격적인 양산준비를 위한 셋업에 들어갔으며, 고객사 승인을 위하여 샘플대응임에도 주야로 인건비 투입
- End-User 승인을 위한 무상샘플공급은 필수로 발생
 - ✓ 단순 Sample 수량 외 개선을 위한 연구원인건비, 실험비용, 분석비용등의 발생
- 안정화 및 효율화 과정에서 초기 비용 발생

사업확대 선비용 반영

- 중국 주하이공장이 완공되어 비용 반영중이나, 비자 등의 이슈로 현지 생산 차질
 - ✓ 중국시장 내 동도금 및 일반약품 판매 확대와 도금외주를 위해서 건축,
 - ✓ 22년 상반기 완공되었으나, 양산화를 위한 Set-up 차질
- 고객사 장비 입고 차질로 인하여 PKG 시장에 기 투자된 대한 인적, 물적 자원의 선비용 발생

원부자재비& 신규사업비용

- 21년 대비 22년 매출이 감소하였음에도 팔라듐을 제외한 나머지 원재료 비용은 30억원 증가
 - ✓ 21년 원재료 사용액 : 118억원
 - ✓ 22년 원재료 사용액 : 148억원
- B2C & OLED 소재 & 전자재료 상사 등 신규 사업 분야에서 약 50억원의 비용 발생
 - ✓ 매출확대로 비용 커버 전망
 - ✓ 일시적인 지출로 향후 과대비용에 대한 지출은 없을 예정

22년 어려운 시장 상황에서 신규사업 및 사업확대, 사회적 이슈로 인한 원가의 상승으로 이익률이 저하되었으나, 이는 영업외적인 이슈로 PCB 화학소재시장에서 당사의 경쟁력이 저하된 것은 아님

Income Statement

(단위:억원)

	제 24기	매출비중	제 23기	매출비중
I. 매출액	1,305.7	100%	1,255.7	100%
II. 매출원가	994.9	76.2%	890.3	70.9%
III. 매출총이익	310.8	23.8%	365.4	29.1%
판매비와 관리비	277.4	21.2%	193.1	15.4%
IV. 영업이익	33.4	2.6%	172.3	13.7%
금융수익	78.8	6.0%	54.5	4.3%
금융비용	77.3	5.9%	59.0	4.7%
기타수익	7.4	0.6%	12.5	1.0%
기타비용	8.1	0.6%	16.4	1.3%
지분법손익	-	-	-	-
V. 법인세차감전순이익	34.2	2.6%	163.9	13.1%
법인세비용	8.2	0.6%	23.5	1.9%
VI. 당기순이익	26.0	2.0%	140.4	11.2%

주요 수익성 지표

	제 24기	제 23기
영업이익률	2.6%	13.7%
순이익률	2.0%	11.2%
EBIT	32.7	168.4
EBITDA (마진율)	112.4 (8.61%)	240.8 (19.18%)
ROE	0.0%	9.1%
총자산회전률	52.8%	56.5%

Balance Sheet

(단위:억원)

	제 24기	제 23기
자산		
현금성자산	531.4	701.9
매출채권	222.1	260.9
유형자산	1,103.5	955.3
기타자산	622.1	544.5
자산총계	2,479.1	2,462.6
부채		
매입채무	33.8	36.9
차입금	503.7	682.5
CB or BW	90.0	95.2
기타부채	338.0	254.4
부채총계	965.5	1,069.0
자본		
자본금	81.6	74.8
자본잉여금	360.1	249.4
이익잉여금	763.2	768.9
기타자본	308.7	300.5
자본총계	1,513.6	1,393.6
부채와 자본총계	2,479.1	2,462.6

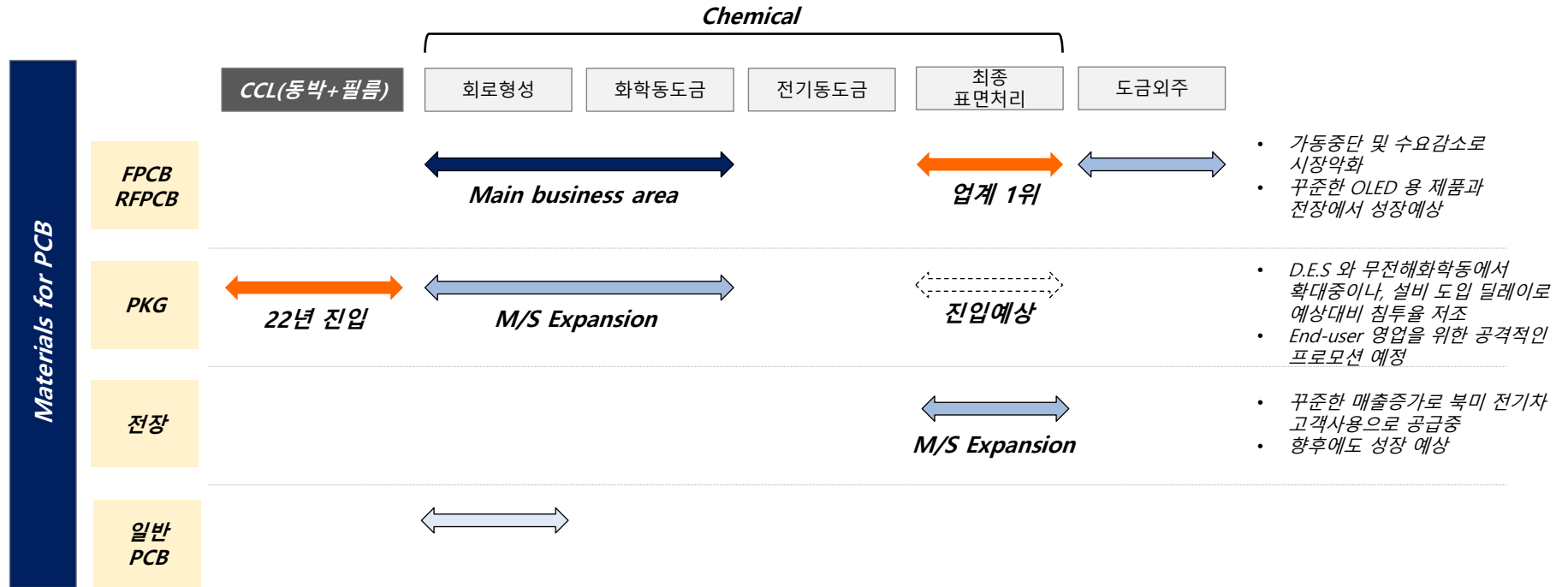
Cash Flow

(단위:억원)

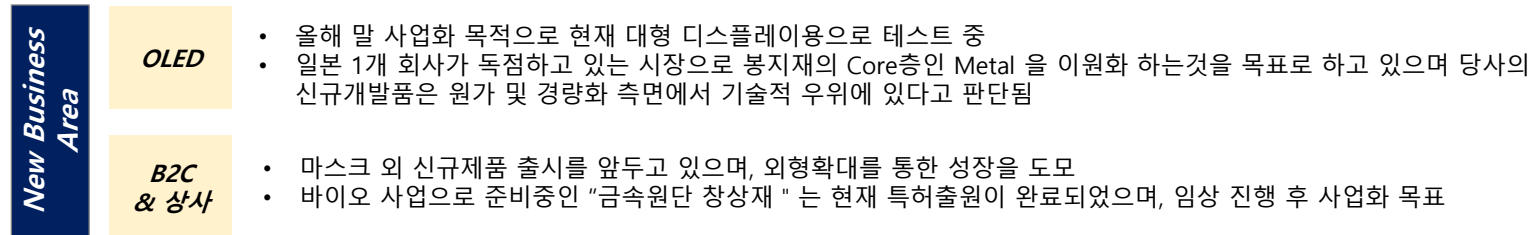
	제 24기	제 23기
기초현금	701.9	556.4
영업활동으로 인한 현금흐름	134.9	224.1
당기순이익	26.0	140.4
감가상각비	79.1	68.5
이자비용	26.0	22.6
파생상품평가손실(이익)	(17.3)	25.9
기타	21.1	(33.3)
투자활동으로 인한 현금흐름	(305.9)	(261.5)
유형자산의 처분(취득)	(228.1)	(229.6)
장단기금융상품의 감소(증가)	(82.3)	1.9
기타	4.5	(33.8)
재무활동으로 인한 현금흐름	9.6	135.2
차입금의 증가(감소)	(178.9)	171.2
CB 또는 BW의 증감	200.0	(40.0)
기타	(11.5)	4.0
현금증감	(161.4)	97.8
환율변동효과	(9.1)	47.7
기말현금	531.4	701.9

사업 전망

Business Area



본업에서의 기술력을 바탕으로 응용가능한 타분야로의 사업 확대



Phase I: 자원 재배치 및 신규시장 침투 ('22 ~ '23)

Phase II: 시장점유율 확대 ('24 ~ '25)

Phase III: 종합 부품소재 회사 ('26 ~)

Chemical Division	Business	<ul style="list-style-type: none"> 반도체 PKG용 화학소재 매출 증대 <ul style="list-style-type: none"> F/RF-PCB → PKG 비중 확대 5G 관련 화학소재 개발 <ul style="list-style-type: none"> Ni-Less 표면처리약품 (Optimus), Nanotus 기술 적용 FPCB 생산기지 이전에 따른 인적, 물적 자원의 재배치 	<ul style="list-style-type: none"> 반도체 PKG용 화학소재 매출 비중 확대 <ul style="list-style-type: none"> F/RF-PCB 매출 < PKG 매출 5G용 화학소재 본격화 <ul style="list-style-type: none"> 고객사 승인 완료 후 본격 양산 중국 시장 매출 본격화 자동차, 항공 등 고부가 시장 진출 	<ul style="list-style-type: none"> Wafer 동도금 화학소재 진출 <ul style="list-style-type: none"> 반도체 관련 시장 확대 6G용 화학소재 개발 <ul style="list-style-type: none"> 고객사 협력을 통한 선행 개발 후 본격 사업화
	Capex	<ul style="list-style-type: none"> 중국 주해 공장 가동 <ul style="list-style-type: none"> 23년 상반기 셋업 목표 베트남 공장 약품 생산 시작 	<ul style="list-style-type: none"> PKG 약품 공급을 위한 국내 약품제조 시설 업그레이드 주해 공장 가동률 향상 (약품, 외주) 	<ul style="list-style-type: none"> 반도체 약품 제조 공장 증설 북미 고객사를 위한 해외공장 증설

신규 Business

Materials Division	Business	<ul style="list-style-type: none"> 고객사 양산 스타트 및 고객사 수 확대 <ul style="list-style-type: none"> PKG 제조사 및 End User 영업강화 양산 효율화 <ul style="list-style-type: none"> 외주공정 내재화 비용 효율화 디스플레이 분야 신규 아이템 사업화 	<ul style="list-style-type: none"> 극동박 본격적 매출 확대 <ul style="list-style-type: none"> 기술우위를 통한 5G 시장 공략 외형확대를 통한 이익률 상승 동박의 연계 Application 시장 침투 <ul style="list-style-type: none"> 저유전 소재, 차폐 소재 등 디스플레이 신규 아이템 양산 	<ul style="list-style-type: none"> 극동박 해외 시장 매출 확대 <ul style="list-style-type: none"> Global Set, Chip 회사들과의 협업 동박을 활용한 다양한 모듈 및 부품의 생산 안정화 및 매출 확대
	Capex	<ul style="list-style-type: none"> 현 공장 양산효율화 <ul style="list-style-type: none"> '22년 세팅, '23년 안정화 동박 신규공장 증설 	<ul style="list-style-type: none"> 동박 신규공장 안정화 및 가동률 상승 <ul style="list-style-type: none"> 국내 신규공장 가동 시작 및 매출확대 Application 생산을 위한 공잔 건설 	<ul style="list-style-type: none"> 모듈 제작을 위한 공장 증설 해외공장 가동 및 안정화

Nanotus(나노투스) 극동박(Ultra thin copper foil)은 도금기술을 활용, 표면에 미세한 돌기를 형성하여 밀착력과 전송손실 모두를 만족하는 차세대 동박으로 End-User의 승인 완료후 현재 전장용 5G통신용 기판으로 양산, 공급중에 있음

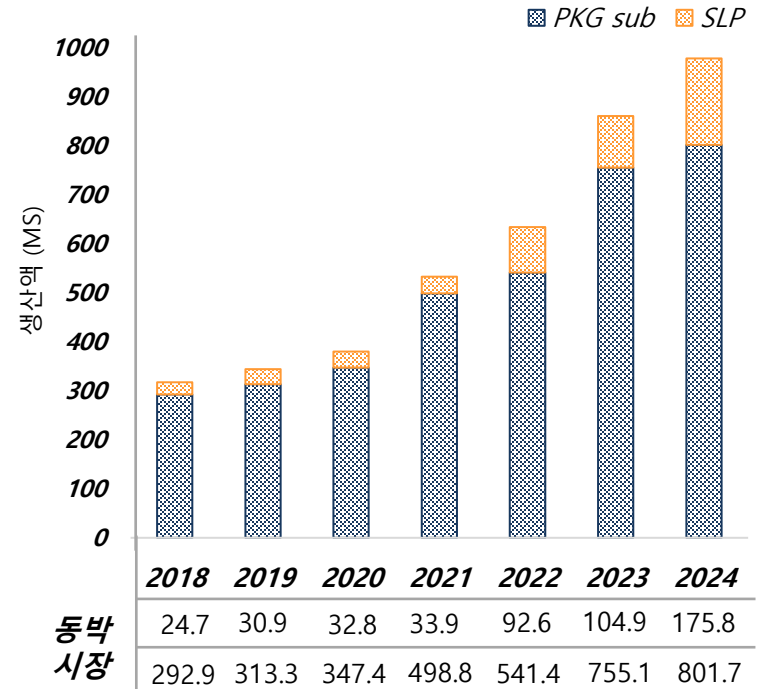
동박 시장의 분류

두께	용도	주요업체
1um~3um	<ul style="list-style-type: none"> PKG 기판의 원소재로 Msap 및 SAP 공법에 적용 	일본 미쓰이社(독점)
6um~8um	<ul style="list-style-type: none"> 전기차 음극재 PCB 	SK넥실리스(한국), 왓슨(중국), 창춘(대만), 일진머티리얼즈(한국)
10um~	<ul style="list-style-type: none"> 일반 PCB 	중국업체 중심 국내 일부 업체

Key factor

- 표면의 조도 (평탄도)
 - 조도가 클수록 밀착력은 상승하나 신호의 전송측면에서 불리
- 얇으면서도 균일한 두께의 동 표면
 - 회로형성과정에서 에칭하여 구리 표면이 사라지게 되는 균일하지 않은 표면을 에칭할 경우 과도한 약품 사용으로 회로가 손상
 - 이에 동박의 얇은 두께는 미세회로 구현의 필수 요소

PKG 기판 시장 자체의 성장과 제조방식인 Msap,SAP 공법 적용의 확대로 2024년 1조원대로 성장 전망



Nanotus® 동박의 기술적 포인트

- 현 공법은 절연필름을 에칭한 표면을 이용하여 밀착력 확보하기 때문에 Control이 어려워 표면이 일정치 않음 → 이에 미세회로 구현 시 불리
 - 별도의 에칭장비 또한 필요하며, 현 동박과 절연필름 공급부족 전망
- 절연필름을 에칭하지 않기 때문에 일정한 조도의 표면을 구현 미세회로 구현에 적합
 - 별도의 투자없이 공정 진행가능
 - 절연필름을 에칭하지 않기 절연필름의 손상이 없음. 이에 제품 구현시 이론상의 Spec을 그대로 발휘
 - 향후 현재 시장을 독점하고 있는 A社 외 제품의 사용이 가능할 것으로 전망

Nanotus®

Cu foil



Cu pattern → DF 박리 후



Seed etching



Seed etching 완료

Conventional

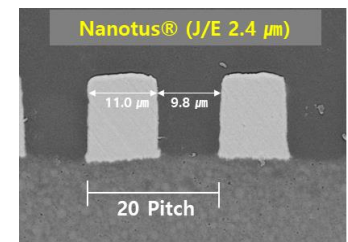
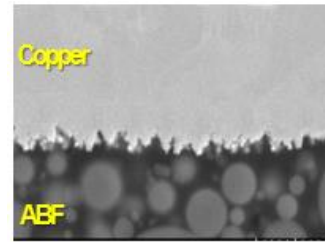


고조도

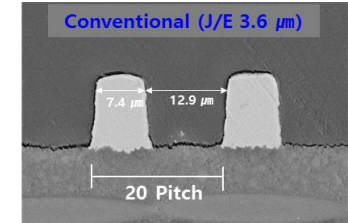
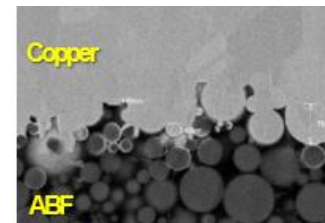


높은 조도로 인한 미 에칭 잔동 발생
회로폭 감소, U/C risk

• 우수한 미세회로 구현 능력 Nanotus



• 기존 공법 : 비균일한 조도로 회로폭 손상



동박과 동도금은 다른건가요?

동박은 필름의 형태로 실제로 구리 표면이 구현되어 있습니다. 주로 PKG PCB 기판 제조(mSAP,SAP) 공법에 사용되고 있습니다. 동도금 화학소재는 액체로 이루어져 있으며 이는 PCB 제조사의 적층 공정등에 주로 사용됩니다.

당사의 동박은 동도금 기술을 바탕으로 만들어졌으며, 연신등의 Negative 공정이 아닌 Positive 한 도금방식으로 표면을 생성하고 있습니다. 이에 얇으면서도 미세한 조도를 가지고 있는 특수한 동박을 개발하게 되었습니다.

PKG 기판은 무엇인가요?

Wafer 를 실장하기 위한 기판으로 Wafer와 부품을 연결해주는 중간다리 역할을 하는 부품입니다. 해당 시장은 한국이 후발주자로서 일본과 대만 업체들이 대다수의 시장을 점유하고 있으며, 화학소재 또한 99% 외산업체가 점유하고 있습니다. FPCB 혹은 일반 PCB 시장 대비 소재의 품질과 기술력, 단가가 모두 높은 시장으로 현재 이 시장에서 당사의 점유율을 확대하고자 노력하고 있습니다.

End-User 가 많이 언급되는데 거래구조가 어떻게 되는건가요?

당사와 매출거래가 생기는 고객사는 국내외 PCB 제조사(삼성전기, ZDT 등) 입니다. 허나 당사의 화학소재를 비롯한 동박까지도 End-User의 승인 없이는 사용 및 교체가 어려운 품목입니다. 그 이유는 작은 소재들조차 연결되어 있는 모듈과 부품등에 영향을 끼치기 때문입니다.

이에 당사의 제품을 고객사 라인에 적용하기 위해서는 삼성 ,애플을 비롯한 Set 제조사와 반도체 회사까지 승인이 필요합니다. 이에 급진적인 매출을 가져가기도 어렵지만 안정적인 매출이 가능한 장점도 존재합니다.

당사의 동박이 5G기판에 적용되나요? BGA는 들어가나요? CSP는 불가능한가요?

당사의 동박은 실장이라는 공정 전에 기판을 만드는 원소재로서 mSAP,SAP 공법에 사용됩니다. 이에 당사의 동박이나 특수한 시장이나 실장방식에 국한되지 않으나 당사의 미세한 조도는 5G 통신기판의 전송손실감소에 큰 강점이 있어 향후 본 시장에서의 성장을 예상하고 있습니다.

동박의 다른 Application은 없나요? 2차전지용으로는 적용이 어렵나요?

현재 당사의 동박을 활용한 여러 비즈니스를 검토하고 있습니다. 고화소 및 5G 안테나에 사용되는 저유전 FCCL, 5G 고주파 차폐필름등도 가능한 어플리케이션이며 2차전지 음극재용 동박시장 또한 경량화 및 원가를 앞세워 해당 분야 또한 진출 가능할 것으로 예상하고 있습니다.

End of document
